

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-006

## 日联科技集团股份有限公司

### 关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：赛美康半导体（无锡）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）以自有资金出资770万元，公司控股孙公司SCPL SEMICONDUCTOR TEST & INSPECTION PTE. LTD.（以下简称“SSTI”，日联科技持股66%）以自有资金出资330万元。
- 本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示：

1、设立控股子公司尚需履行市场监督管理等相关部门审批/备案程序，审批/备案程序以及最终完成时间存在不确定性。

2、控股子公司运营受宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代等因素影响，存在业务拓展不及预期的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

公司于2025年10月28日审议通过了《关于全资子公司收购境外公司控制权的议案》；2026年1月8日，本次收购已完成交割，为了推进本次收购后的整合工作，进一步开拓公司在高端半导体检测设备领域的业务布局，强化高端检测

技术与产品供给能力，完善公司在半导体失效分析、缺陷检测等领域的产品线，为中国市场半导体客户提供高端检测设备，公司拟与SSTI共同出资设立控股子公司，在国内建立研发和生产基地，实现相关设备的国产化。控股子公司注册资本为1,100万元，日联科技持股70%，SSTI持股30%。

## （二）对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《日联科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议，已经公司经营管理会议审议通过，公司经营管理层具体负责办理控股子公司的设立等相关事宜。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需向政府有关主管部门申请办理公司的设立登记事宜，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

## 二、投资标的基本情况

|                        |  |
|------------------------|--|
| 公司名称                   | 赛美康半导体（无锡）有限公司   |
| 注册资本                   | 1,100万元  |
| 出资方式                   | 自有资金   |
| 股权结构                   | 日联科技持股70%；SSTI持股30%  |
| 经营范围                   | 半导体检测设备、光电检测设备、失效分析设备、自动化检测系统的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、货物进出口、技术进出口等。 |
| 注册地址                   | 江苏省无锡市   |
| 上述信息以市场监督管理部门最终登记结果为准。 |  |

## 三、本次对外投资对公司的影响

### （一）对公司技术研发的影响

本次对外投资将实现日联科技与SSTI在半导体检测技术领域的深度协同，SSTI是行业领先的半导体检测诊断与失效分析设备供应商，在光子发射检测、激光时序探针检测、热红外检测等技术领域具备国际先进水平，与公司现有的先进X射线检测技术形成高度互补。控股子公司设立后，双方将共同搭建一体化技术研发平台，推动高端半导体检测技术在国内快速落地、迭代升级与成果转化，进一步提升公司在先进制程半导体检测领域的技术壁垒，持续强化核心技术竞争力。

## （二）对公司产品线与业务结构的影响

通过本次对外投资，公司将完善在半导体失效分析、缺陷检测等领域的产品线布局，将产品体系延伸至半导体设计调试、良率提升、失效分析等关键环节，形成半导体领域“物理缺陷检测+功能检测分析”的协同布局，实现高端半导体检测设备国产化研发、生产、供应，增强公司对晶圆厂、设计公司、封装企业等半导体客户的综合服务能力，优化整体产品结构 with 业务结构，推动公司发展成为一站式半导体检测解决方案提供商。

## （三）对公司市场竞争力的影响

中国是全球规模最大、增速最快的半导体市场，高端检测设备国产化替代空间广阔。通过本次对外投资，公司与SSTI在国内建立生产制造基地，实现相关设备的国产化。公司将充分利用自身的制造和整合能力、国内人力资源和成本优势，赋能控股子公司运营管理。同时依托公司在国内深耕多年所建立的客户资源、渠道网络、服务体系等市场优势，叠加双方的技术优势，有效提升控股子公司产品竞争力、交付能力及服务质量，有望快速切入国内晶圆制造、先进封测、存储半导体等核心赛道，进一步扩大公司在国内高端半导体检测市场的占有率，提升市场竞争力，打开业绩增长新空间。

## （四）对公司财务的影响

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，控股子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次投资资金来源为公司自有资金，预计对公司本年度财务状况及经营成果不构成重大影响。

## 四、对外投资的风险分析

1、设立控股子公司尚需履行市场监督管理等相关部门审批/备案程序，审批/备案程序以及最终完成时间存在不确定性。

2、控股子公司运营受宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代等因素影响，存在业务拓展不及预期的风险。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年2月28日